

UF 120LA 底部填充胶 产品数据表

卓越的耐热循环性能
100% 兼容助焊剂残留
可承受 5 次 260 °C 回流焊

简介

UF 120LA 是一种高填料、高纯度的液态环氧底部填充胶，可流入极窄的间隙。该产品与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容，在 5×260 °C 回流焊条件下不发生焊点变形，其性能优于需要清洗工艺的同类底部填充材料。UF 120LA 适用于 BGA、Flip Chip、CSP 等应用，并可用于存储卡、芯片载体、混合电路、多芯片模块等多种先进封装中的裸芯片保护。

使用 UF 120HA 的主要优势包括

- ❖ 与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容
- ❖ 免除清洗工艺及其带来的环境污染 显著降低制造成本
- ❖ 通过 5×260 °C 回流焊
- ❖ 焊点无任何变形
- ❖ 性能优于采用清洗工艺的同类底部填充材料
- ❖ 可流入 20 μm 的微小间隙
- ❖ 低温快速固化

物理特性

产品名称	UF 120LA 液體封裝劑
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	1.6 g/cc

粘度 (Spindle#4/20rpm)	6000 – 9000 cP
已固化材料性能	
Tg ASTM D3418-82	150 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 28$; $\alpha_2 = 88$
剪切强度 (FR4 / FR4)	3500 psi
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化工艺

在 150 °C 条件下固化 20 分钟（不包含升温时间）。可根据客户需求，提供并评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下，若材料存放于密封的原始包装容器中，保质期为 6 个月。超过该期限存放，产品粘度可能会升高。储存时应避免 水分侵入、挥发及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全须知

UF 120LA 为环境友好、无毒材料。在操作和使用过程中，仍建议遵循常规的工业卫生操作规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS(安全数据表)。

包装规格

UF 120LA 为环境友好、无毒材料。在操作和使用过程中，仍建议遵循常规的工业卫生操作规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS (安全数据表)。